1、基于现有测试版，测试中还有一些情况需要进一步分析：（1）芯片工作一段时间，电流会突然增加超过限流。降温后可以工作的时间增加。（2）芯片的主时钟频率在某些频率下数据量激增，图像呈现不均匀分布，粒子分布在左下方和右下方密度高。中上区域击中次数偏少。（3）像素阵列读出的延时分析，激光？（4）数据读出有误码，有时误码率极高。可以考虑串口延时调节的颗粒度细化后再测测（5）温度80度时数据会出错（来自张颖的反馈）

（6）高计数率+大曝光面积容易丢数（朱宏博）2、设计高速版及测试系统？ 目前测试系统用的串口输出仅为160Mbps，设计的高速串口还有一个模式为4.48Gbps3、芯片卷起来的测试？